

证券代码：688270

证券简称：臻镭科技

浙江臻镭科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	太平养老、华泰柏瑞、鹏华基金、汇添富、平安养老、兴业全球基金、民生加银、易方达、招商基金、东方红基金、交银施罗德、汐泰投资、西部利得、格林基金、中欧基金、申万菱信、华夏未来、文博启胜、广发基金、建信理财、前海开源、国盛资本、东方阿尔法、重阳投资、宝盈基金、国金基金、民生通惠、长城基金、南土资产、由榕资产、国泰基金、拾贝投资、紫金矿业投资、浦东创投、时代复兴、泰阳投资、天弘基金、玄元投资、汇升投资、彤源投资、汇盛投资、泰康资产、儋石基金、中盛晨嘉、百年保险、瑞银资产、天弘基金、中信建投、朱雀基金、泰信基金、新华资产、景顺长城、天治基金、创金合信、恒生前海、泓德基金、前海开源、建信基金、中航基金、趣时资产、财通基金、中意资产、长信基金、永赢基金、盘京投资、永安财产、正圆投资、鹤禧投资、诚通基金、衍航投资、智合远见、安信基金、创富兆业
时间	2024年4月1日、2024年4月2日
地点	浙江臻镭科技股份有限公司一号会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：郁发新 董事会秘书、财务总监：李娜

	<p>证券事务代表：孙飞飞</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>一、介绍环节</p> <p>浙江臻镭科技股份有限公司成立于2015年9月11日，专注于集成电路芯片和微系统的研发、生产和销售，并围绕相关产品提供技术服务。公司产品及技术已广泛应用于无线通信终端、通信雷达系统、电子系统供配电等特种行业领域，并逐步拓展至移动通信系统、商业低轨卫星等民用领域。公司芯片产品技术性能达到国际先进水平，产品作为核心芯片应用于多个型号装备。目前，公司已成为国内通信、雷达领域中射频芯片和电源管理芯片的核心供应商之一，且是国内少数能够在特种领域提供终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片、微系统及模组等产品整体解决方案及技术服务的企业之一。</p> <p>二、问答环节</p> <p>Q1：看到公司整体毛利率下降了4个多点，请问原因是什么？</p> <p>A1：公司整体毛利率变化的主要原因是产品结构发生变化，微系统及模组产品销售收入占比提升，该部分产品毛利率相对较低，导致公司整体毛利率有所降低。</p> <p>Q2：2024年人员和费用的展望？</p> <p>A2：2023年公司扩充了近60人，基本上都是研发人员，2024年总体上人员增幅不会像2023年这么快，统筹规划是小幅略增。</p> <p>Q3：公司年报里有提到CX8845这款芯片，市场对这款产品也很感兴趣，请公司详细介绍下，谢谢！</p> <p>A3：CX8845是公司投入较大精力，自主研发、全正向设计的产品，ADC采样频率4GSPS，精度14bit，DAC采样频率12GSPS，精度14bit，为国内已知的综合性能指标最高的高速高精度ADC/DAC芯片产品，具有宽带、大动态、高集成度等特征，可应用于全数字相控阵、宽带中频收发系统及低轨商业卫星等领域，目前已仿真验证，正开展优化工作。</p> <p>Q4：请问公司有在低空经济里做相应布局吗？</p> <p>A4：低空经济是今年年初起来的概念，公司各大产品线均可提供成熟产品与技术服务。</p> <p>Q5：公司今年年报，新增了一块水下传感的内容，公司在水下装备这块是做了布局吗？</p> <p>A5：水下这块我们主要提供高精度芯片产品，公司前期对水下传感等新兴领域进行了调研，预计水下设备需求将稳步增长，因此公司研发了CX74E1、CX71E1等主要应用于水下传感、振动</p>

测量领域的新产品。公司也在此强调下，我司是通用型芯片研发企业，我司不掌握客户的应用场景和具体应用任务。

Q6:近期陆续有上市公司公告获得了数据链的大单,请问公司在数据链这块订单情况如何?

A6: 公司的射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、微系统及模组等产品均可应用于数据链领域，去年下半年开始明显感受到行业整体在回暖，公司也陆续收到相应的订单。

Q7: 请问公司对低轨商业卫星未来的看法如何? 公司有哪些布局?

A7: 公司看好低轨商业卫星的发展，也是目前单体公司里面布局最全面的公司之一。公司的电源管理芯片在已成熟供货的基础上新研了多款模块化产品，23年推广十分顺利；微系统及模组方面，公司SIP组件产品凭借着其优异的性能与较高的性价比，在卫星互联网下游市场获得了进一步的拓展；高度高精度ADC/DAC的业务布局现在仍处于早期，公司为下一代低轨商业卫星及地面配套设备新研了多款新产品及型号，布局了诸如多通道射频收发芯片、数字波束成形芯片（DBF芯片）、射频收发数字波束成形一体化芯片等多款芯片，部分产品已进入样品推广阶段。

Q8: 目前市场有在传，未来基于成本的考虑，商业卫星会大量采用工业器件?

A8: 低轨卫星抗辐照要求可放松，但原则上低轨卫星的电源芯片还是需要抗辐照能力。

Q9: 公司微系统及模组这块产品去年增速低于预期，请公司讲讲大致原因?

A9: 公司去年微系统及模组销售产品收入近5000万，定制研发收入近2000万，这部分主要以技术服务合同形式体现，故记在技术服务收入里，综合来看有70%多的增长。目前我们的微系统还是以SIP组件产品出货为主，未来随着量上来后，微系统价格优势显现，公司会逐步往三维异构微系统转换。

Q10: 公司三维异构微系统产品的研发进度如何了?

A10: 三维异构微系统是一种多芯片一体化集成产品，其集成度比SIP组件更高。公司在2023年已完成部分三维异构微系统产品的关键技术攻关，现已初步具备研发量产产品的能力。公司将在2024年开始着手部分三维异构微系统量产产品的研发，并在市场中进行试用推广。同时公司将持续聚焦装备信息化、小型化的需求，响应客户对于产品高频化、轻薄化、多功能化的需要，持续布局异构集成低成本射频微系统设计技术的研发，研发更多高频段、大功率、超宽带的货架产品，将公司的产品形

	式从完全定制化向半货架半定制化转变。
附件清单(如有)	无
日期	2024年4月3日